

第7回（社）計測自動制御学会
システムインテグレーション部門 講演会

7th SICE System Integration Division
Annual Conference



講演概要集

SICE[®]



2006.12.14-17 札幌コンベンションセンター

組込プロセッサ+Windows CEへのRTミドルウェアの実装

○三浦 俊宏, 水川 真, 安藤 吉伸, 土屋 裕 (芝浦工業大学)
池添 明宏 (株式会社セック), 安藤 慶昭 (産業技術総合研究所)

Implementation of RT middleware with Windows CE on Embedded Processor

○Toshihiro MIURA, Makoto MIZUKAWA, Yoshinobu ANDO, Yutaka TSUCHIYA (SIT)
Akihiro IKEZOE (SEC) Noriaki ANDO (AIST)

Abstract: In this paper, we propose porting of RT middleware to embedded system ,adopting Windows CE. It becomes possible to increase the reusability of software also to various devices This combination of Windows OS and RTM-aist is expected to improve development efficiency by using the state of the art development environment.

1. 背景

現在のロボットの多くは単純な繰返し作業を行う産業用ロボットが大半を占めている。しかし、今後のロボットには人間の生活を支援する為の様々なサービスが要求されている。したがって、各ユーザの様々な要求を満たす、様々なロボットを提供しなくてはならない。しかし、現在のロボット開発では各製造者がそれぞれ独自の仕様でロボットの開発を行っている。そのため、ロボットには再利用性がなく開発に長い開発期間を要し、膨大な開発技術者と費用が必要になっている。こうした問題点を解消するために、ロボットの技術要素をソフトウェアレベルでモジュール化し、再利用性を高める為のミドルウェアとしてRTミドルウェア(Robot Technology Middleware)^[1]の研究・開発が行われている。

このRTミドルウェアは、まだ開発段階にあり開発がしやすいデスクトップPCで開発が行われている。しかし、今後ロボット技術が一般的に普及するにあたって価格・消費電力・搭載スペース等の問題や開発効率の問題を考慮すると、組込系プロセッサ上にRTミドルウェアを実装することが必要となると考えられる。

この問題に対してわれわれは組込プロセッサ上にLinux系OSを使用し、RTミドルウェアを実装する方法を検討し実装した。^[2]本報告では、組込みプロセッサ上へRTミドルウェアを普及させるために、windows系OSが搭載された組込みプロセッサに対してRTミドルウェアを実装するための手法についての検討を行ったので報告する。

2. RTミドルウェア

RTミドルウェアは次世代のロボット開発用プログラム開発フレームワークであり、ロボット制御プログラムの再利用性向上のためにネットワーク分散コンポーネント化技術による共通プラットフォームを確立することを目指して、産業技術総合研究所で開発が進められている。RTミドルウェアのシステム構成は、Fig.1に示すようにRTコンポーネント(Robot Technology Component)と呼ばれるソフトウェアコンポーネントを複数接続する構成である。このようなコンポーネントを複数つなぎ合わせることで、柔軟なシステム開発が可

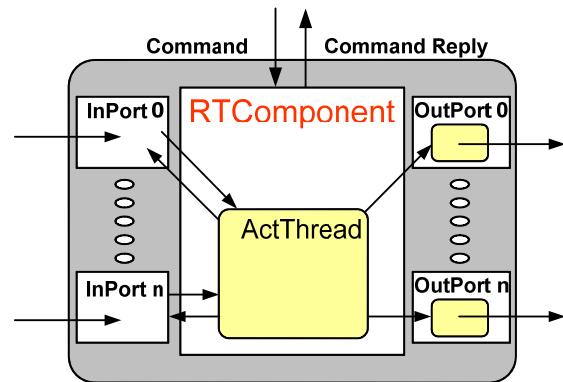


Fig.1 Composition of RT Component

能となる。コンポーネントの接続作業はGUI(Graphical User Interface)を用いて動的に構成、変更することが可能である。RTミドルウェアは、OMGが策定している分散オブジェクト技術CORBAをベースとしている。そのため、様々なプラットフォームでプログラムの修正なしで動作させることができとなり、再利用性が非常に高い。

3. Windows CEへのRTミドルウェアの実装

3.1 実装によるメリット

Windows CEへRTミドルウェアを実装することによりロボットだけではなく組込系WindowsOSを用いたPDAやモバイル携帯など様々なものでもソフトウェアの再利用性が格段に向上升する。

また、今まで実装例がなかった組込系WindowsOSの実装例を確立することにより、Windows系OSとLinux系OSの全てにRTミドルウェアを実装することができる。つまり、デスクトップ系と組込系に存在するWindows系OSとLinux系OSの様々なOSに依存することなく開発を行うことが可能となる。

3.1 実験プラットフォーム

RTミドルウェアを実装する為の実験環境として、我々が開発している物理エージェントロボットPAR04Rの統括・制御を行っているロボットコントローラサブシステムを用いる。使用する組込系プロ

セッサは、今後のPARの研究開発を考慮し、現存する組込系プロセッサの中でも上位系のプロセッサを用いる必要がある。また、ロボットコントローラには、外部との通信に必要なEthernetコントローラと、内部の各サブシステムとの通信に必要なCANコントローラが必要である。以上の要求仕様より、組込系プロセッサにはルネサステクノロジ社製のSH4(SH7760)を選定し、ボードにはこのSH7760が実装されているZMP社製のSH4ボードを選定した。本ボードには、組込系Windows OSの1つであるWindows CE.NET 4.2が搭載されている。SH4ボードの概観と詳細を、それぞれFig.2, Table1に示す

3.2 RTミドルウェアの実装方法の検討

ZMP社製のSH4ボードに搭載されているWindows CE.NET 4.2へはRTミドルウェア、OpenRTM-aist-0.2.0の開発段階のWindows版をベースにし実装していく。このOpenRTM-aist-0.2.0の構成をFig.3に示す。Fig.3のOpenRTM-aist-0.2.0はCORBA実装部分に大部分をCORBA2.6仕様に追従しているOmniORBを使用し動作している。しかし、OmniORBはデスクトップ系のWindowsやLinux系OSにしか対応しておらず組込系であるWindowsCEには対応していないという問題がある。そのため、そのままOpenRTM-aist-0.2.0をWindowsCEへ実装することは不可能である。そこで、本研究ではOmniORBの部分をWindowsCEに対応したTAO^[3]に変更し、Fig.3のTAO版OpenRTMのように実装を行う。このTAOとはOmniORBやJavaなどと同様にCORBAの実装の1つであり、プラットフォームとしてWindows、Linuxなどの他に組込系OSのWindowsCEが対応している。本研究ではWindowsCEに対応したTAOを使用しZMP社製SH4ボードのSDKをプラットフォームとして実装を行う。

現段階までにWindows版OpenRTM-aist-0.2.0のIDLをTAOでコンパイルしてスタブ・スケルトンを作成しTAOへの移植を行った。今後、WindowsCEへの実装し動作確認を行っていく。

4. 研究課題

RTミドルウェアは、まだ開発段階でありデスクトップPCをメインに開発が行われている。従って、デスクトップ系より処理速度が遅く機能が制限されている組込系で動作させたときに、一般的に使用できる動作速度を確保できるかという問題が生じると考えられる。この問題点については、RTミドルウェアを実装したPAR04Rを用いて検証していく。

5. まとめ

本報告では、ロボットシステムの汎用性と拡張性を考慮し、RTミドルウェアをWindowsCEが実装された組込みプロセッサへと適応させる方法について検討を行った。具体的には、ZMP社製のSH4ボードを使用しWindowsCEへOpenRTM-aist-0.2.0のCORBA部分のOmniORBをTAOへと変更することでRTミドルウェアを実装する。今後の課題としてWindowsCEへRTミドルウェアを実装したときの動作速度を検証する必要がある。

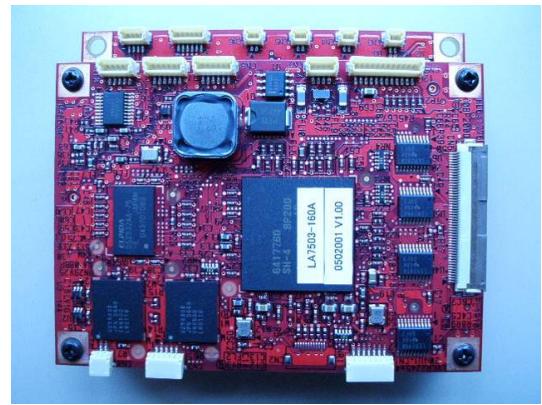


Fig.2 SH4 board of made by ZMP company

Table1 SH4 board

CPU		SH4 (SH7760) 200MHz
メモリ	SDRAM	64MB (32MBをユーザプログラムに使用可能)
	ROM (SuperAND)	64MB (32MBをディスクとして使用可能)
各種インターフェイス	シリアル	TTL
	CAN	1Mbps(max) CPU内蔵 HCAN2, HA13721
	Ethernet	100BASE-T (AX88796L, TG110-S050N2) RJ45コネクタ外付け
	サウンド	AC97Codec (CPU内蔵 HAC, STAC9757T) AMP (LM4863) マイク入力、ステレオ 8Ωスピーカ出力、ステレオ、I/W
	CF	2スロット (3.3V/5V対応)
	無線LAN (オプション)	IEEE802.11b CF型ワイヤレスLANカード対応
電源仕様(ボード単体)		DC 5.0V/2.5A 入力 1.5V, 3.3V: ボード内で生成
外形	基板寸法	基板2枚構成:組合せ高さ 30mm max A基板(CPU, RAM等): 84.4 × 60.0mm B基板(CF, I/Oコネクタ等): 84.4 × 70.0mm

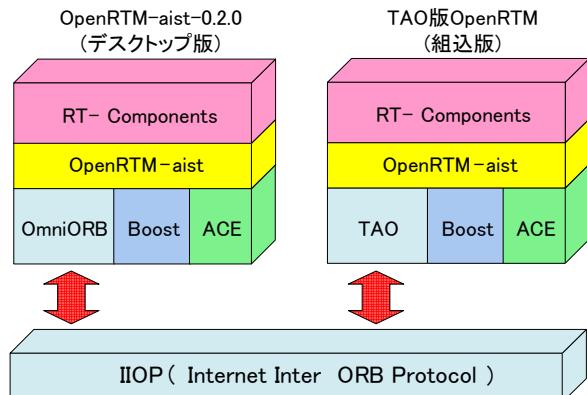


Fig.3 The transplant of OpenRTM-aist-0.2.0

参考文献

- [1] OpenRTM-aist-0.2.0 デベロッパーズガイド
独立法人 産業技術総合研究所知能システム部門・タスクインテリジェンス研究グループ
- [2] RTミドルウェアを用いたPAS分散処理系の考察
土屋 他, SI2005
- [3] TAO (The ACE ORB) HP
<http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html>
- [4] RTミドルウェアプロジェクト HP
<http://www.is.aist.go.jp/rt>
- [5] 分散オブジェクト技術のすべて
日本事業出版社・小泉修(著)